

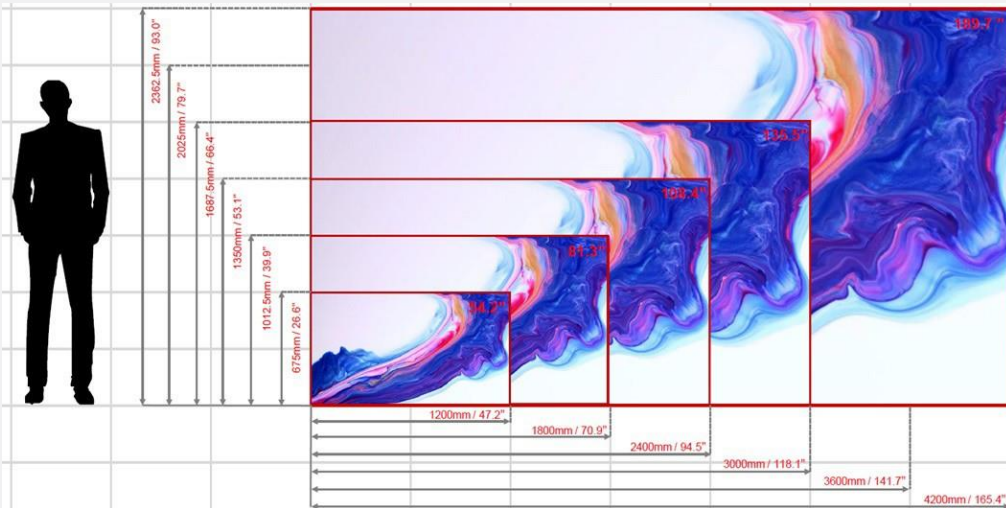
RSV-HCP

壁掛マルチディスプレイの代わりに

対応ドットピッチ(mm)	屋内用モデル
0.9375 / 1.25 / 1.5625 / 1.875 / 2.5	

16対9比率 マルチ液晶ディスプレイのかわりに

キャビネットは16：9の比率を採用しているため、2K、4K、8Kの正確なディスプレイ画面を構築しやすくなります。液晶(LCD)ディスプレイはベゼルがあるため、LCDを複数使ったマルチディスプレイはパネル間に必ず線が入りますが、LEDはどれだけサイズを増やしてもパネル間に煩わしい線が入らず、最適な壁掛けディスプレイを構築可能です。



メンテナンスも非常に簡単

筐体内部は、基板周りやモジュールすべてがコネクタ接続によるワイヤレス構造になっているため、ケーブル接触不良によるリスクを軽減。

小ピッチ / COB対応

通常のLED実装(SMD)とは異なるCOB実装対応

従来のLED実装方式(SMD) :

発光LEDチップをワイヤー(金線や銅線)で接続したカプセル型チップをPCB基板ではんだ実装する方式



SMDを樹脂コーティングした技術(GOB) :

SMDは、基盤の上に小さなLED素子が乗っている状態のため少しの衝撃でチップが外れてしまいます。

GOBはSMDを樹脂コーティングすることで対衝撃性に強くなります。

COB実装方式 :

PCB基板に直接発光LEDチップを実装する方式。SMD以上の高精細小ピッチが実現でき、表面もコーティングされているため耐久性も優れています。



2020年ごろのCOBは超高精細が可能でしたが、流通量が少なく、費用コストが非常に高いのがデメリットでした。しかし近年ではCOBの流通性も増してきたことで、大幅にコストも抑えられるようになりました。

当社の製品はCOB製品を開発・製造しているメーカーより直接取引することで他社より高品質低価格をご提供可能です。

壁掛けやスタンドなど幅広い設置



例：壁掛け



例：自立スタンド

仕様書 ※シリーズは一部のみ記載しております。

シリーズ名	RSV-HCP		
画像ピッチ	0.9375mm	1.25mm	1.5625mm
パネル寸法(幅×縦×奥行)	600mm×337.5mm×37.48mm		
パネル解像度	640p×360p	480p×270p	384p×216p
モジュールサイズ	150mm×168.75mm		
輝度	800nits		
消費電力	200W/1パネルあたり		